

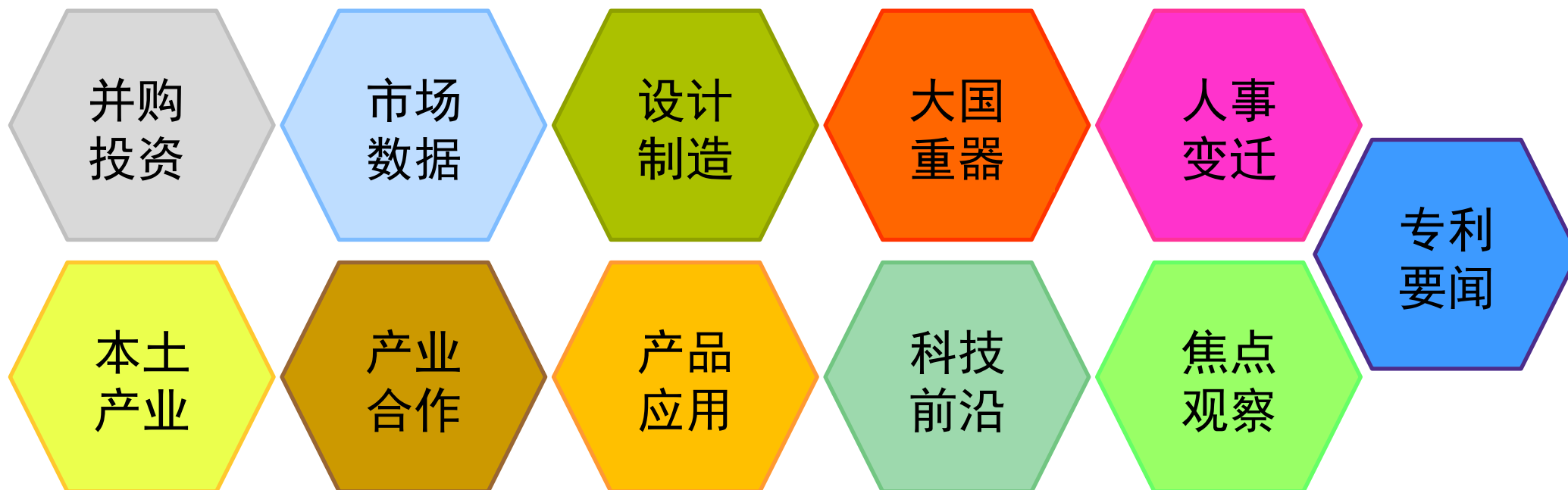
半导体产业新闻半月刊（精华版）

2019/0701-2019/0714



专题分类

SIIP CHINA
SEMI产业创新投资平台



并购投资

- 重点：
- ①斥资26亿美元，思科收购光模块供应商Acacia。
 - ②芯原微电子、北京科华分别完成新一轮战略融资。
 - ③应用材料或将收购日本同行国际电气。
 - ④日盈电子拟收购惠昌传感器90%股权。



领域	时间	事件	原因/内容	资金(美元)
IC设计	2019/07/12	芯原微电子获小米投资	战略融资。通过此次投资，小米成为芯原的第四大股东。	
IC装备	2019/07/01	应用材料或将收购日本同行国际电气	业务增强。将扩大应用材料公司的产品阵容。	23亿
IC测试	2019/07/02	科纳米获B轮融资	战略融资。由高捷资本（ECC）与纳川资本联合领投。	
IC材料	2019/07/07	北京科华获新一轮融资	战略融资。本轮融资由沃衍资本、江苏盛世投资、紫荆资本、深圳市投控通产新材料创业投资企业、四川润资、北京高盟新材料等投资机构投资。	0.25亿
传感器	2019/07/05	日盈电子拟收购惠昌传感器90%股权	业务拓展。	0.24亿
光学元件	2019/07/10	思科将收购光学元件制造商Acacia	战略收购。持续布局硅光芯片。	28.4亿



本土产业

- 重点：
- ①10亿元数字产业基金落地福州，加速外延集成电路等产业。
 - ②上海成立人工智能发展联盟、武汉成立城市仿真实验室技术联盟。
 - ③中国科学院EDA分中心落户张家港。
 - ④摩尔精英旗下合肥速芯封装厂正式开业。



【10亿元数字产业基金落地福州】

6月19日，海峡基金港助力科创企业成长投融资对接会在福州市举行，期间举行了规模10亿元的福州市数字产业基金签约仪式。福州市数字产业基金是毅达资本联合福州市政府以市场为导向设立的。基金聚焦电子设备制造业、软件和信息服务业等数字经济产业，同时加速外延大数据采集及算法开发、新型显示及光电信息、新材料、智能装备、集成电路及IC设计等新兴产业。

【上海人工智能发展联盟成立】

7月2日，上海人工智能发展联盟一届一次理事会召开，标志着上海人工智能发展联盟正式成立。上海人工智能发展联盟是按照上海市推进人工智能发展实施意见中关于组建人工智能联盟的总体要求，由上海市经济和信息化委员会指导筹建的，联盟以服务上海打造人工智能高地为总体目标，以搭建政、产、学、研、资、用资源协同平台为主体任务，以开展人工智能专业服务和国内外交流为主要抓手，促进上海人工智能技术、产业、应用的有机协同。目前，联盟共有55家首届理事单位，其中包括科大讯飞、商汤科技、寒武纪、地平线、阿里云、深兰科技、微软亚洲研究院、腾讯科技等。

【上海临港集团与国微集团签署战略合作协议】

7月8日，上海临港集团与国微集团达成了战略合作协议。双方将重点围绕半导体产业生态链、芯片设计研究及人才培养、半导体产业基金等方面，在临港地区构建半导体产业生态圈，打造服务于半导体产业生态链的芯片产业园。



【武汉成立城市仿真实验室技术联盟】

6月28日，**武汉城市仿真实验室技术联盟成立**。该联盟吸引了阿里巴巴、腾讯、华为、科大讯飞、海康威视、四维图新、烽火科技等十多家知名企业，和武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学等高校共同参与。按照协议，参与的高校和企业将与市自然资源和规划局在数据资源、模型研究和软件平台研发等方面进行合作。

【长三角石墨烯科创城落户G60科创走廊】

6月28日，**长三角石墨烯科创城在G60科创走廊的上海松江区揭牌成立**，计划投资10亿元打造60000平方米的公共实验室、展厅、众创空间。

【无锡与华为签署战略合作】

7月1日，**无锡市政府与华为公司签署战略合作协议**，将进一步加深在物联网、云计算、大数据、工业互联网、人工智能、车联网、智慧城市等领域的战略合作。华为无锡市锡山区软件开发云项目、华为车联网创新中心合作项目两个落地协议同步签约，将推动双方合作进入崭新阶段。根据协议，双方将在物联网、大数据、工业互联网、人工智能、智慧城市领域开展战略合作，在车联网等领域共同开展创新示范应用，开展领先的ICT人才培养，共同营造良好的产业生态，加快推动无锡打造“新型智慧名城”。



【海信、海康威视等12个项目落地湖南湘江新区】

6月30日，湖南湘江新区举办了“聚力新产业·奋进新发展”产业项目集中签约活动，现场共12大项目签约落户湘江新区。本次签约的项目包括了海信智能系统研究院、海康威视湖南研发中心和销售总部、新一代半导体产业链新材料新能源产学研中心等项目，盖了智能终端、新能源、新一代半导等多个新兴产业。

【与Ferrotec（中国）集团再签约重大项目，铜陵市将建设新材料产业园】

日前，铜陵市与Ferrotec（中国）集团举行长江半导体增值服务和新材料产业园项目签约仪式。这次战略合作框架协议和相关项目协议的正式签订，既与长三角产业布局、安徽“一核一弧”半导体产业规划高度契合，也与铜陵市产业转型升级路径深度融合，必将有力促进铜陵市半导体产业链、价值链、创新链扩展延伸，助推产业转型升级，开创市企合作新篇章。

【摩尔精英旗下合肥速芯封装厂正式开业】

7月3日，摩尔精英全资子公司—合肥速芯微电子开业典礼在明珠产业园隆重举行。速芯的服务，覆盖了遥控、安防、物联网、MCU、AI、工控、高性能计算芯片等多种产品类别，依托摩尔精英供应链的严格品质控制，已经成功出货给首批客户，凭借稳定的高良率，赢得了客户认可。



【江西赣州签约欣亿半导体制造基地等项目】

7月6日，江西赣州经开区“三请三回”招商活动进行集中签约，现场共签约7个项目，总投资91.6亿元，涉及电子信息、智能制造等领域。

【台湾利科光学半导体落地湖北仙桃】

7月6日，台湾利科光学半导体封装及产业链项目在湖北仙桃举行签约仪式。该项目总投资75亿元，分两期建设，一期投资35亿元，主要开展光学半导体封装、触控屏幕及显示成品模组生产。

【江西抚州光电及智能制造产业项目正式落地】

7月10日，江西省抚州高新区与新海宜科技集团光电及智能制造产业项目签约仪式举行。该签约项目总投资50亿元，主要包括光电智能制造项目，新能源产业核心零配件项目，IDC大数据云计算中心项目。

【创维光电项目落户广东鹤山】

近日，创维光电项目签约仪式在广东鹤山工业城举行。该项目总投资约25亿元，全部达产后产值将超80亿元。



【中国科学院EDA分中心落户张家港】

6月29日，中国科学院EDA中心张家港分中心成功落户。中国科学院EDA中心是中国科学院面对中国IC与系统设计产业发展对技术和人才的迫切需求，于2002年11月经中国科学院批准设立的法人事业机构，是中国科学院面向全院集成电路与系统设计领域科研与教育的网络化公共平台。

【瓴盛落户上海IC设计产业园】

日前，瓴盛科技宣布落户上海集成电路设计产业园。该公司注册资本为29.8亿元，其自主研发的SoC芯片项目已被列入全国第二批重大外资项目。

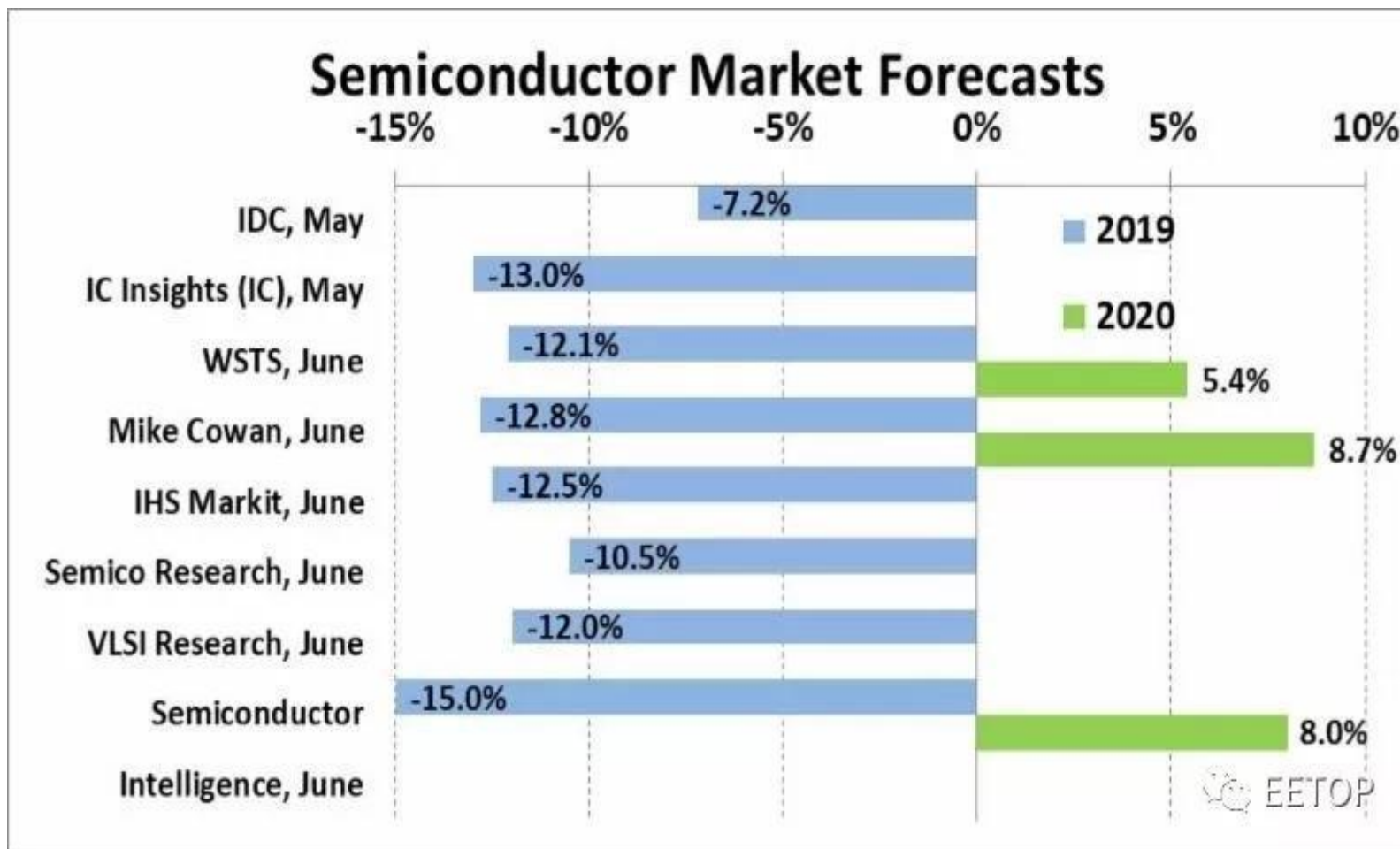


市场数据

- 重点：
- ①2019年半导体市场疲软，将出现大幅衰退。
 - ②两年的疯狂投资后，DRAM资本支出今年将暴跌 28%。
 - ③2019年上半年全球代工前十：华虹略增，其余均下滑。
 - ④2023年5G手机出货量将超4G，中国全球第一。



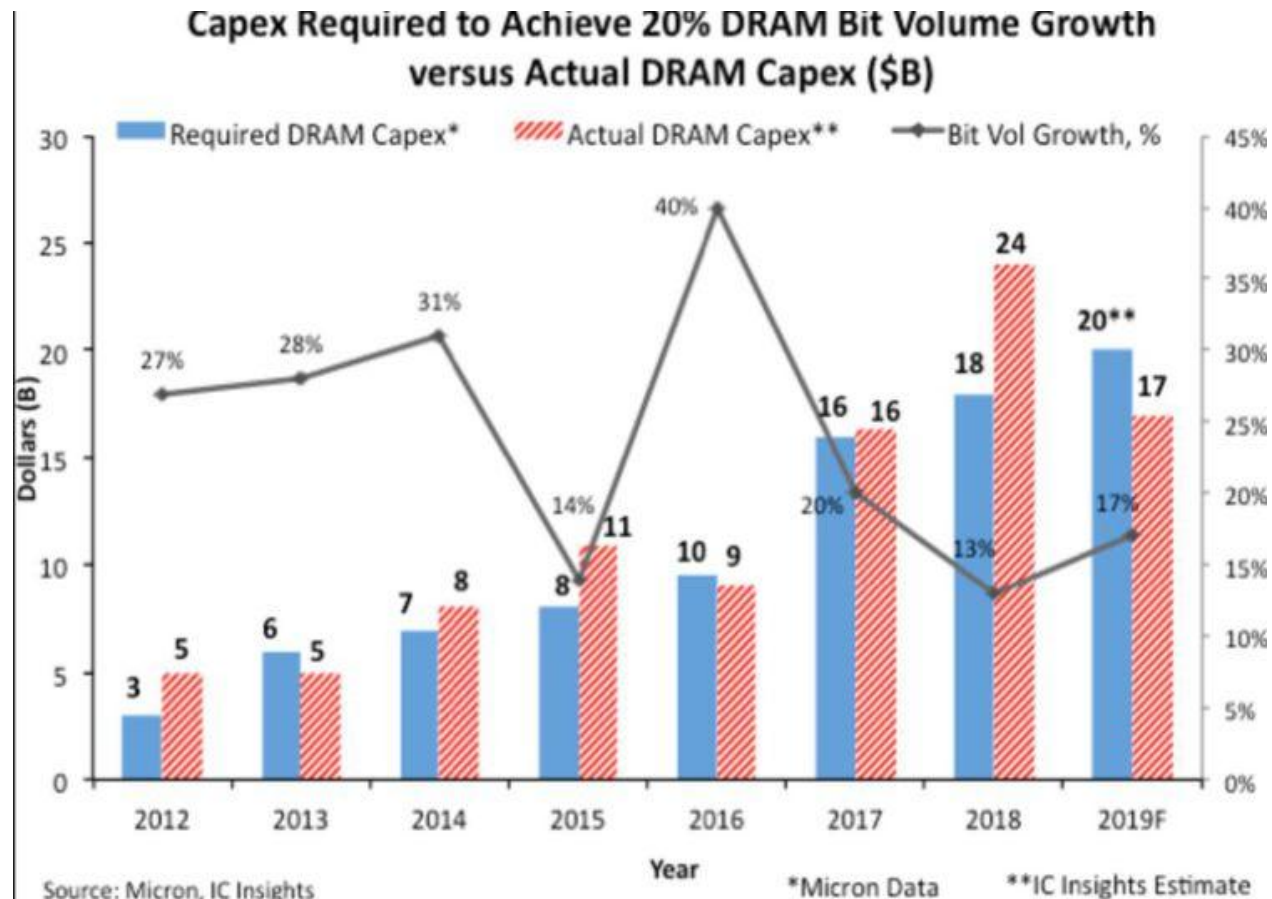
【2019年半导体市场疲软，将出现大幅衰退】



根据WSTS数据，2019年的半导体市场预测从-7.2%到-15.0%不等。其他预测在-11%到-13%之间。



【ICinsights: DRAM资本支出今年将大跌28%】



IC Insights预计2019年的实际DRAM资本支出预计将低于维持20%的销量增长所需的支出。这可以抵消2018年的超支，并有助于在2020年开始回归DRAM市场的供需平衡。



【全球硅晶圆市场里的中国X因】

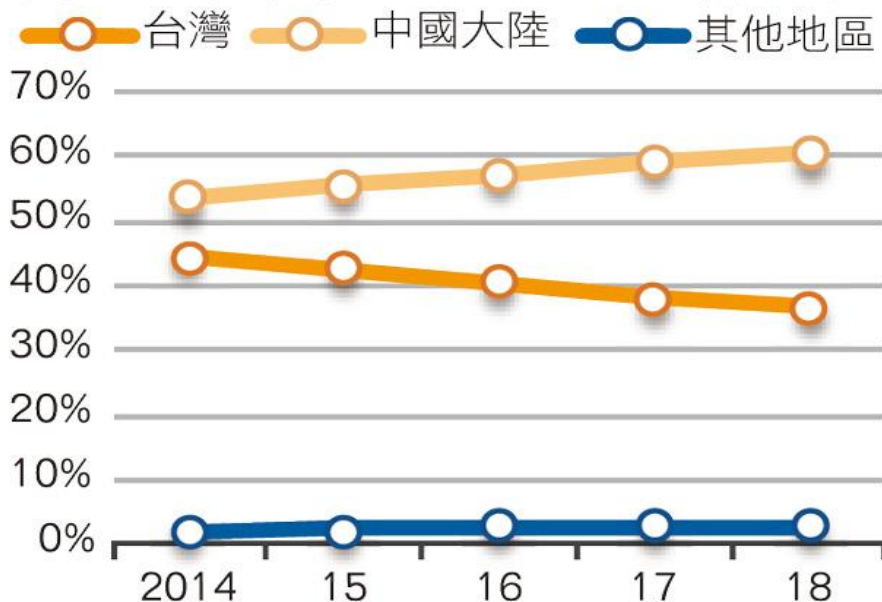
企业	投资方	规划新增产能（万片/月）		进度	预期18年底产能		预期19年底产能		预期20年底产能	
		8寸	12寸		8寸	12寸	8寸	12寸	8寸	12寸
天津中环（宜兴）	中国	75	60	建设中			50		75	15
金瑞泓（徐州）	中国	40	10	建设中			5		10	
新昇半导体	中国		60	建设中		10		20		40
杭州中芯晶圆半导体Ferrotec	合资	30	20	建设中			10	5	30	10
宁夏银和	外资	35	20	试产					10	
成都超硅	中国		25	建设中						5
重庆超硅	中国	15	5	建设中			5		15	5
郑州合晶	中国	20	25	投产	10		20	5	20	10
西安奕斯伟	中国		5	建设中						5
徐州鑫晶（协鑫）	中国	30	30	建设中					10	
广西启世	中国		40	未落地						
合计	中国	245	300		10	10	90	30	170	90

我国近几年在大硅片国产化进程方面不断加速，据华创证券统计，目前约有11个国产大硅片项目在建，这些项目合计规划产能达到8英寸硅片245万片/月，12英寸硅片300万片/月，在不久的将来若能完全落实，则可以满足国内硅片的自给需求。



【中美科技对峙有转圜空间，PCB产业竞争面临新挑战】

台PCB廠在陸生產比重逐年提升



資料來源：TPCA、DIGITIMES整理，2019/6

台 PCB 廠在陸生產應用比例

應用項目	產值佔比	年成長率
IC 載板	3.6%	2.6%
4 層以上硬板	35.8%	-0.5%
單雙面板	10.0%	-1.8%
HDI	18.6%	17.6%
軟板	29.7%	18.1%
軟硬結合板	2.3%	5.8%
導熱基板	0.2%	-7.2%

資料來源：TPCA，DIGITIMES 整理，2019/6

就算有不少负面因子浮现，现在中国大陆成为全球PCB生产重镇的事实，短期内应该很难改变。不管是基础设施建设还是人力资源管理上，中国大陆具备的竞争优势依旧胜过周边其它地区，甚至上游CCL厂都打算因应PCB生产持续转移至中国大陆的状况，在中国大陆持续扩充产能。业者指出，要让PCB产业从大陆移回台湾已经很困难，转向东南亚难度又更高，短期内这仍是相对不切实际的选择。



【2019年上半年全球代工前十：华虹略增，其余均下滑】

2019 年上半年世界集成电路晶圆代工前十大企业排名

序号	企业名称	2019 年上半年营收额 (百万美元)	2018 年上半年营收额 (百万美元)	同比 (%)
1	台积电	14581	16397	-11.1
2	三星	5558	6315	-12.0
3	格芯	2570	3034	-15.3
4	联电	2218	2624	-15.5
5	中芯	1444	1722	-16.1
6	高塔	616	648	-4.9
7	华虹	450	440	2.3
8	力晶	445	676	-34.2
9	世界先进	439	452	-2.9
10	东部高科	276	284	-2.9
11	前十大合计	28597	32592	-12.3
12	其他企业	1388	1561	-11.1
13	合计	29985	34153	-12.2

资料来源：拓璞产研/JSSIA 整理 (2019.7.1)

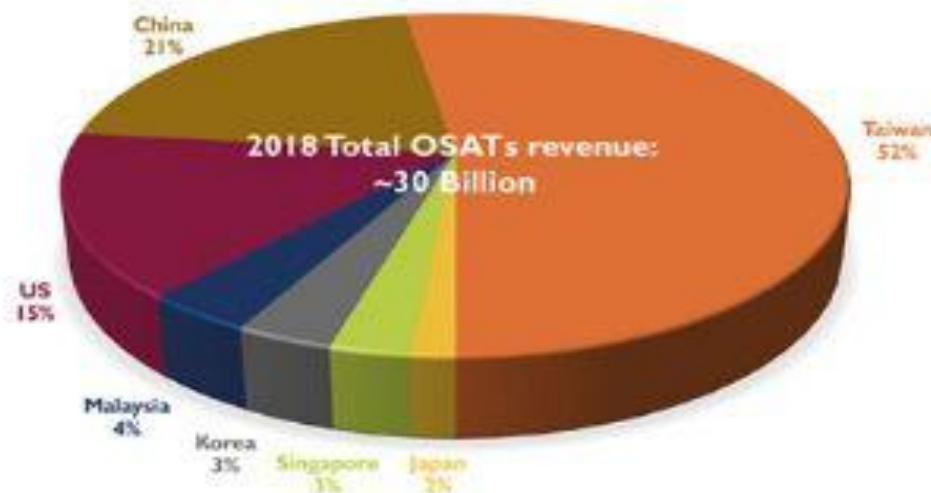
2019年上半年度世界集成电路晶圆代工营业收入预计为299.85亿美元，同比下降12.2%，其中前十大企业营业收入预计为285.97亿美元，同比下降12.3%。在前十大晶圆代工企业中，除华虹半导体同比增长2.3%外，其余九大企业都呈下滑之势。



【封装新格局：一些IDM和Foundry也在企业内发展封测业务】

2018 Advanced packaging revenue generated by OSATs* – Breakdown by geographic area**

(Source: Status of the Advanced Packaging Industry report, Yole Développement, 2019)

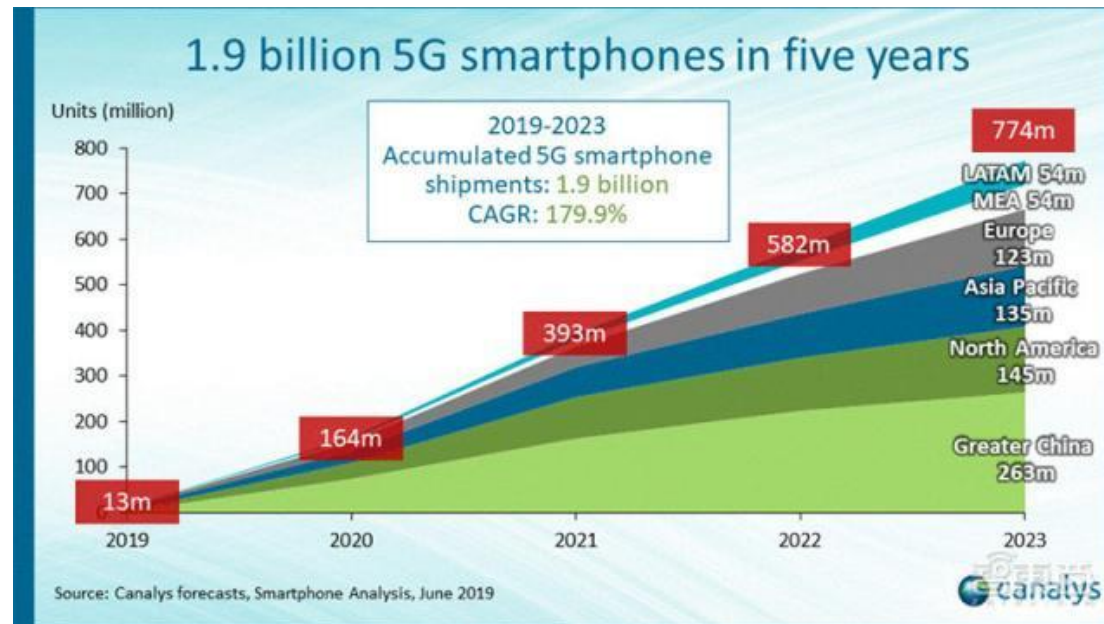
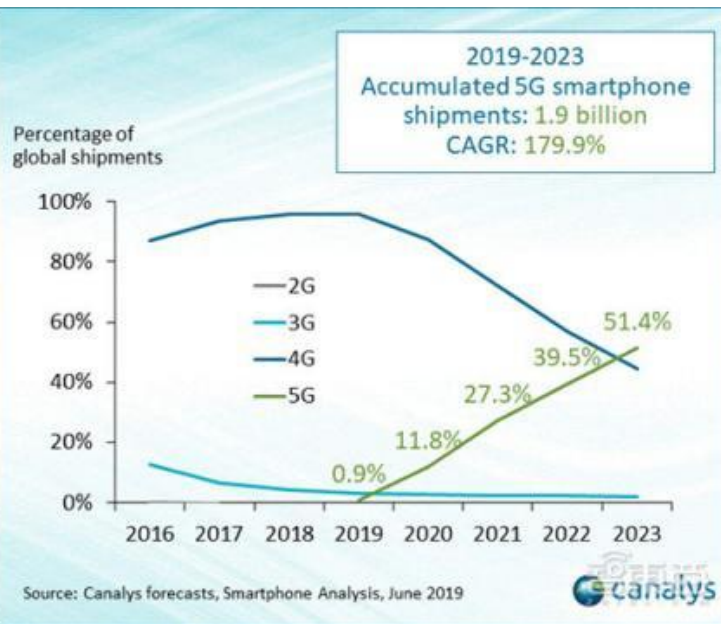
2018 Total OSATs revenue:
~30 Billion* Outsourced Semiconductor Assembly & Test companies.
** This analysis takes into account OSATs headquarters only.Yole Développement
半导体行业观察

Yole近期公布了2018年销售额TOP25的封装、测试企业(OSAT)排名：中国台湾以52%的比例遥遥领先，第二为中国大陆（21%），第三为美国（15%），后面有马来西亚（4%）、韩国（3%）、新加坡（3%）和日本（2%）。



【2023年5G手机出货量将超4G，中国全球第一】

1.9 billion 5G smartphones will ship in the next five years, overtaking 4G shipments in 2023



Canalys称，全球5G智能手机出货量将在2023年超越4G，其中中国出货量将位列全球第一，预计将占全球市场的34%。



【全球PC第二季度销量排名：联想重回第一】

Table 1. Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2Q19 (Thousands of Units)

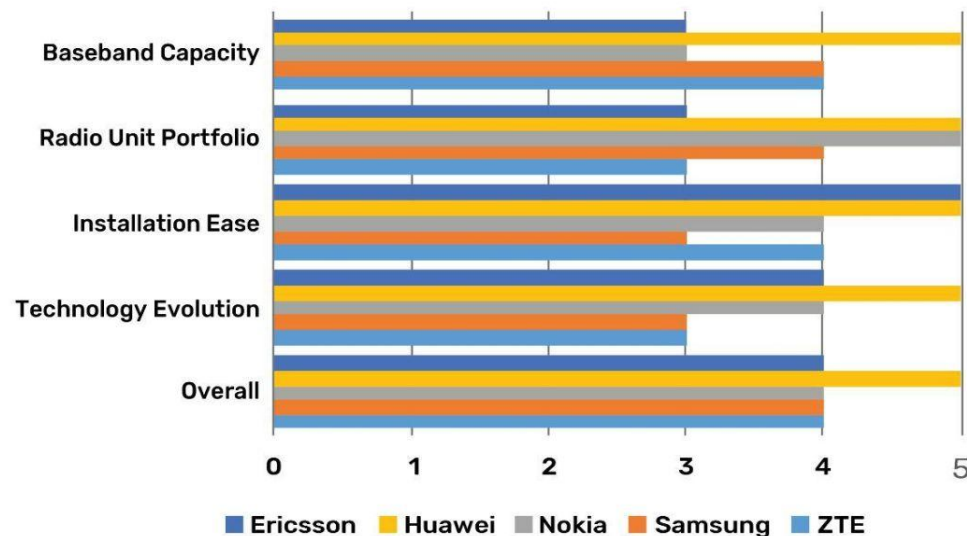
Company	2Q19 Shipments	2Q19 Market Share (%)	2Q18 Shipments	2Q18 Market Share (%)	2Q19-2Q18 Growth (%)
Lenovo	15,774	25.0	13,608	21.9	15.9
HP Inc.	13,992	22.2	13,636	22.0	2.6
Dell	10,654	16.9	10,435	16.8	2.1
Apple	3,711	5.9	3,720	6.0	-0.2
Acer Group	3,395	5.4	3,968	6.4	-14.4
ASUS	3,100	4.9	3,442	5.5	-9.9
Others	12,347	19.6	13,231	21.3	-6.7
Total	62,974	100.0	62,040	100.0	1.5

Gartner披露了全球第二季度PC销量数据：经过两个季度的下滑后，全球个人电脑市场在2019年第二季度增长了1.5%。



【全球首份5G设备提供商报告：华为四大方面都获第一】

Global Competitive Landscape
Assessment 5G RAN vendor
ratings, June 2019



Source: GlobalData, Technology Intelligence Center

数据分析公司GlobalData发布全球首个5G RAN（无线接入网）排名报告，该报告主要针对业内五大主流设备商做相应研究，包括爱立信，华为，诺基亚，三星和中兴。报告里面指出，评判移动运营商的四个关键指标分别是基带容量，射频产品组合，部署简易度和技术演进能力。华为全面领先。



【MCU国产化提升的“张力”何在？】

China Cortex MCU vendors market share in 2018

Vendors	market share in 2018 estimation
STMicroelectronics	47.4%
NXP	25.2%
GigaDevice	9.4%
Nuvoton	5.1%
Atmel	2.0%
Infineon Technologies	1.7%
Texas Instruments	1.3%
Silicon-lab	1.5%
Spansion	1.1%
Others	5.3%

Source: IHS Markit

© 2019 IHS Markit

据IC Insights研究报告，全球MCU市场将于2020年达到高峰，销售额达209亿美元，出货267亿颗。而占据C位的中国市场自承其重，据IHS研究报告，2021年中国市场规模将达64.2亿美元。

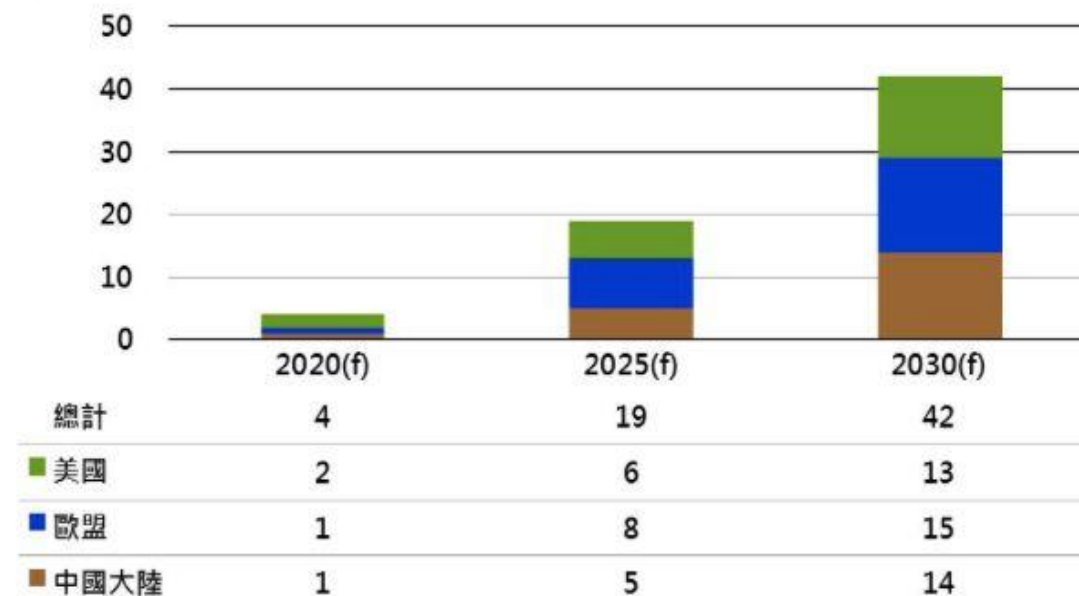


【SiC功率半导体市场起飞】

電動車趨勢將帶動全球充電樁及SiC需求

主要地區電動車充電樁數量預測

單位：百萬個



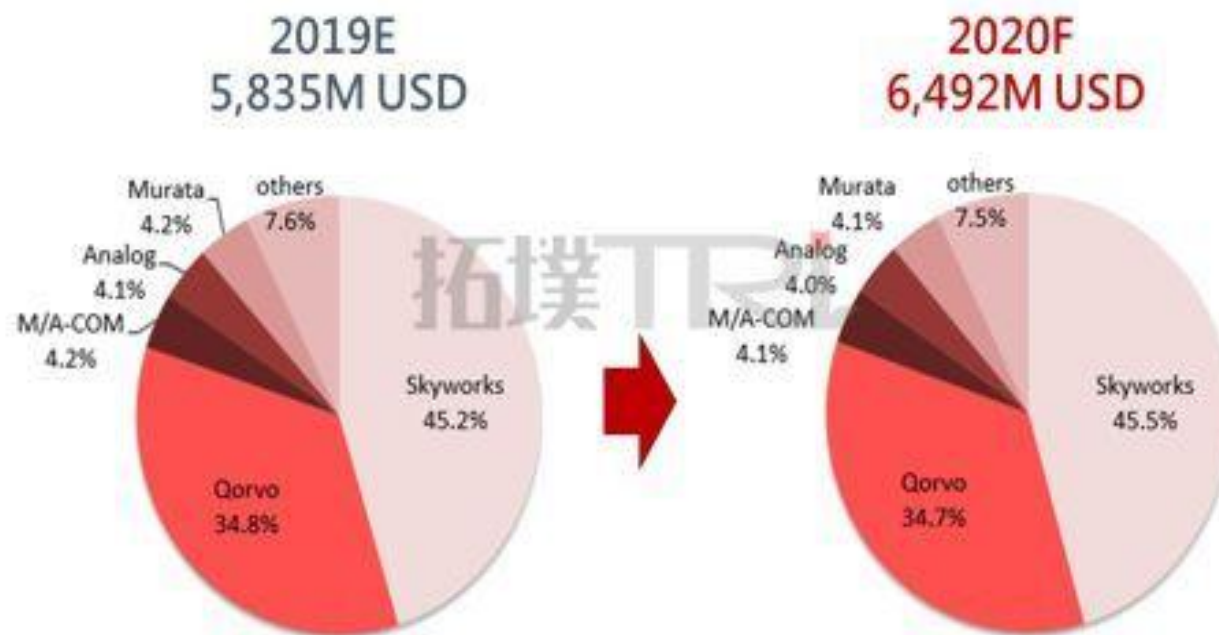
資料來源：意法半導體，DIGITIMES Research整理，2019/6

据Yole称，在汽车和其他市场的推动下，2017年SiC功率器件业务达到3.02亿美元，较2016年的2.48亿美元增长22%，到2023年，SiC功率半导体市场预计将达到15亿美元。



【GaAs射频器件2020年总营收将达64.92亿美元】

图 2019-2020年GaAs射频前端组件IDM厂预估营收



数据来源：拓璞产业研究院，2019年07月

拓璞产业研究院指出，由于现行射频前端器件制造商因手机通讯器件的功能需求，逐渐以GaAs晶圆作为器件的制造材料，加上随着5G建设逐步展开，射频器件使用量较4G时代倍增，预料将带动GaAs射频器件市场于2020年起进入新一波成长期。



【2018年CMOS图像传感器市场营收达155亿美元】



- Long term growth potential should be extinguished by 2024.
- Despite semiconductor annual growth slow down, CIS should remain a market of MEMS last resort maintaining growth in the upper single digit.

2015~2024年CMOS图像传感器市场数据及预测

麦姆斯咨询介绍，CMOS图像传感器市场在2018年达到155亿美元，超过半导体市场总体营收的3%。



产业合作

- 重点：
- ① 百度飞桨与华为麒麟芯片达成深度合作。
 - ② 艾迈斯半导体和SmartSens就3D和NIR传感器开展合作。
 - ③ 江波龙与得一微达成全面战略合作，推动中国存储生态发展。
 - ④ Tessolve牵手Johnstech合作开发4site 5G毫米波封装测试解决方案。



领域	合作公司/单位	目的
存储	江波龙、深圳得一微电子	双方将以全产品线主控合作为契机强化协作，通过资源共享和优势互补，深入控制芯片定制、提升产品品质，积极参与推动中国存储生态发展。
激光雷达	TowerJazz、Lumotive	联手为激光雷达打造全固态光束操纵器件。
AI	百度、华为	国内第一个自研AI深度学习框架百度“飞桨”与华为麒麟芯片达成合作。
传感器	艾迈斯半导体、SmartSens	就3D和NIR传感器开展合作，旨在加快市场交付速度，扩大3D产品在移动设备、计算机、消费电子和汽车等领域的多元化应用。
5G	韩国SK电信、三星	成功实现了基于5G的数据通信。
5G	SK电讯、德国电信	设立5G合资公司，加码5G发展。
5G	NI、Tessolve、Johnstech	合作演示了一个4 site 5G毫米波IC封装件测试解决方案，本解决方案能应对5G mmWave封装零件测试的相关技术挑战，有助于降低成本，也可让生产mmWave 5G IC的半导体制造商降低上市时间延迟的风险。

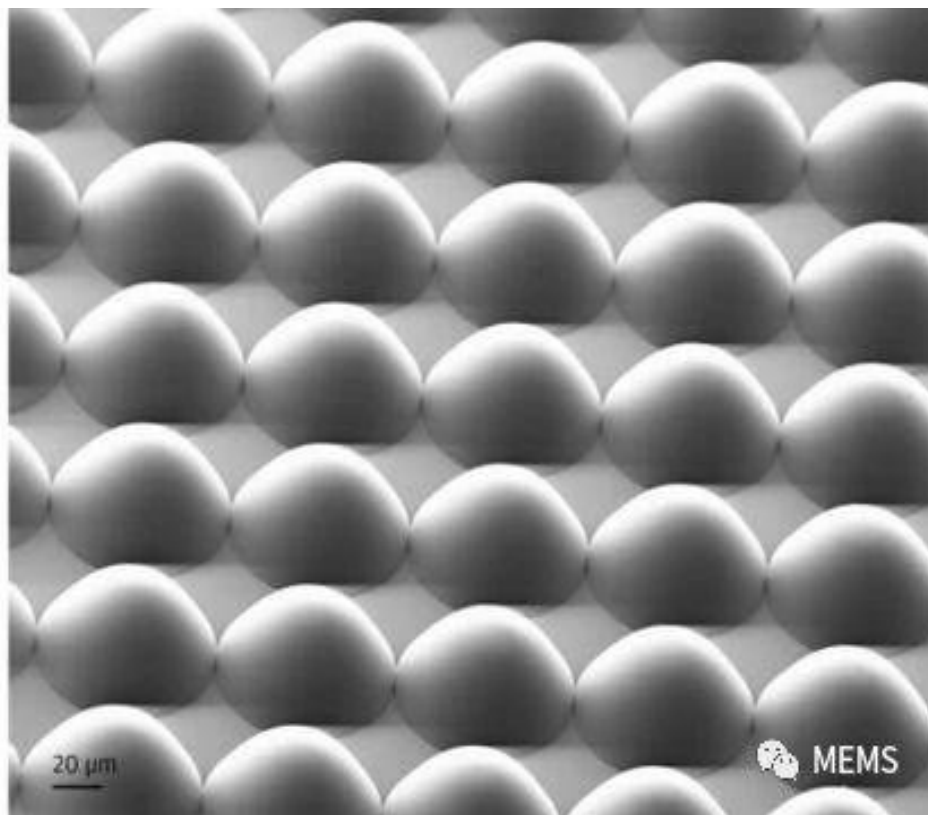


设计制造

- 重点：
- ①台积电打造40纳米无线系统SoC。
 - ②粤芯：首批样品已出货，良率达到预期目标。
 - ③英伟达下一代GPU将采用三星7nm EUV工艺。
 - ④欧盟计划投资1000亿欧元打造本土电池产业。



【Nanoscribe推出创新的微透镜阵列制造设备Quantum X】SIIP CHINA SEMI产业创新投资平台



Nanoscribe公司Quantum X
(左) 制造的微透镜阵列
图像 (右)

Nanoscribe公司推出了基于增材制造的微透镜阵列制造设备Quantum X。Quantum X是纳米级和微米级高分辨率增材制造系统，Nanoscribe产品系列又添一员“大将”，专为高精度微光学无掩模光刻而设计。



【中芯晶圆8英寸半导体硅抛光片下线，预计10月量产】

SIIP CHINA
SEMI产业创新投资平台

6月30日，杭州中芯晶圆半导体股份有限公司的首批8英寸半导体硅抛光片顺利下线。中芯晶圆是由日本Ferrotec株式会社、杭州大和热磁电子有限公司及上海申和电子有限公司共同投资成立的，2017年9月28日落户钱塘新区，首个项目包括3条8英寸、两条12英寸半导体硅抛光片生产线。

【粤芯：首批样品已出货，良率达到预期目标】

6月29日，广东省发展和改革委员会主任葛长伟等一行调研了广州粤芯半导体技术有限公司12英寸厂。粤芯半导体总裁及首席执行官陈卫表示，截止到目前，粤芯半导体第一阶段的生产线调试已经完成，首批样品已经出货，良率已达到预期目标。

【台积电打造40纳米无线系统SoC】

台积电、Ambiq Micro近日共同宣布，采用台积电40纳米超低功耗（40ULP）技术生产的Apollo3 Blue无线系统单芯片（SoC）缔造领先全球的最佳功耗表现。



【立昂微成功拉制出第一根12英寸硅单晶棒】

7月2日，立昂微子顺利拉制出一根长1.5米、重达270公斤的12英寸半导体级硅单晶棒，标志立昂微半导体硅材料业务板块的12英寸大硅片产业化布局取得了初步成效。

【村田制作所再建新厂】

村田制作所近日宣布，由于中长期需求有望增长，计划投资约140亿日元在旗下野洲事业所内兴建新厂房，扩充MLCC等电子零件的电极材料产能。

【JSR开发和销售用于5G高速传输的绝缘材料】

JSR于7月1日宣布，其开发并推出了用于5G移动通信系统低介电常数，低介电损耗正切绝缘材料。

【欧盟计划投资1000亿欧元打造本土电池产业】

7月7日，在过去的几个月，欧盟委员会副主席Maros Sefcovi所领导的一个政府团体与制造商、开发银行以及商业贷款机构进行了磋商，讨论投资超过1000亿欧元，打造一个锂离子电池供应链，为电动汽车提供动力。



【中兴：已完成7nm芯片设计并量产，正在研发5nm 5G芯片】

据央视消息，中兴通讯CEO徐子阳表示，在5G基站芯片方面，中兴通讯已经完成7nm工艺芯片的设计并量产，目前正在研发5nm工艺的5G芯片。

【英伟达下一代GPU将采用三星7nm EUV工艺】

7月2日，英伟达韩国业务负责人Yoo Eung-joon在首尔举行的新闻发布会上证实，英伟达下一代GPU将采用三星的7nm EUV工艺生产。

【联发科发布全新AIoT平台i700】

7月9日，联发科发布具高速边缘AI运算能力，可快速实现影像识别的AIoT平台i700，进一步提升联发科技在人工智能领域的领导地位。



产品应用

- 重点：
- ①百度正式发布远场语音交互芯片“鸿鹄”。
 - ②瑞芯微宣布基于RK1808的人工智能计算棒正式开售。
 - ③视涯科技公布开发中的两款硅基OLED显示屏。



领域	公司/单位	产品及特性
语音交互芯片	百度	发布远场语音交互芯片“鸿鹄”。鸿鹄芯片使用了HiFi4自定义指令集，双核DSP核心，平均功耗仅100mW。这款芯片是根据车规级标准打造，主要应用于车载语音交互、智能家居等场景。
CPU	海信	搭载紫光展锐新一代4G LTE芯片平台—虎贲T310的海信F30S系列智能手机正式在国内发布。
AI芯片	瑞芯微	基于其RK1808芯片的人工智能计算棒将在瑞芯微Toybrick官方企业店正式开售。该计算棒是瑞芯微专门为AI人工智能平台及产品开发者而设计，具备强大的人工智能编程及深度学习能力的AI加速器。
车规级安全芯片	苏州国芯科技	近日推出了符合AEC-Q100标准的自主可控的车规级安全芯片。
传感器	elmos	推出基于E909.21/22芯片的新一代手势识别传感器方案。
显示器	宏碁	发布新款曲面电竞显示器XZ272 P 面板类型为VA。
显示器	视涯科技	公布开发中的两款硅基OLED显示屏。



大国重器

重点：①北京两个大科学装置—高能同步辐射光源和多模态跨尺度生物医学成像设施同日开建。
②清华AI研究院成立自然语言处理与社会人文计算研究中心。



【北京怀柔科学城两个大科学装置同日开建】

6月29日，怀柔科学城两个大科学装置——高能同步辐射光源（HEPS）和多模态跨尺度生物医学成像设施同日开建。一个是探测微观世界的“超级显微镜”，另一个是生命医学领域世界一流的重大科技设施。

【清华AI研究院成立自然语言处理与社会人文计算研究中心】

7月1日，清华大学人工智能研究院自然语言处理与社会人文计算研究中心成立仪式举行。这是人工智能研究院成立的第8个中心，此前已经成立了7个研究中心，分别为知识智能研究中心、听觉智能研究中心、基础理论研究中心、智能人机交互研究中心、智能机器人研究中心、智能信息获取研究中心、视觉智能研究中心。

【中科院石墨烯工程实验室正式揭牌】

6月29日，中国科学院石墨烯工程实验室在中科院宁波材料技术与工程研究所召开了第一届理事会第一次会议。宁波材料所、上海微系统与信息技术研究所、上海硅酸盐所、重庆绿色智能技术研究院、山西煤炭化学研究所、大连化学物理研究所、兰州化学物理研究所、苏州纳米技术与纳米仿生研究所、电工研究所、金属所等十家共建单位以及石墨烯产业链上下游企业（包括宁波墨西科技有限公司、重庆墨希科技有限公司、上海烯望材料科技有限公司、上海空间电源研究所、浙江中车新能源科技有限公司）的理事会成员参加会议。

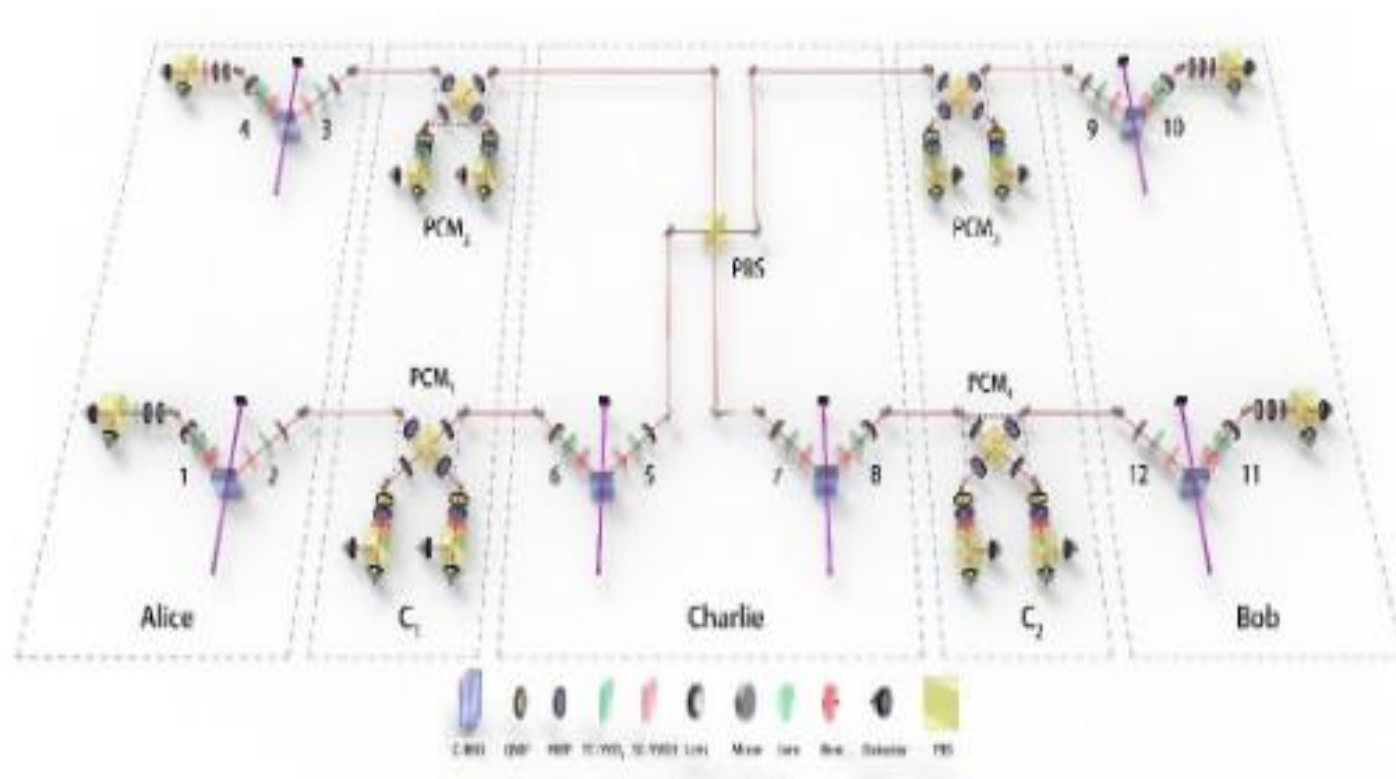


科技前沿

重点：①中科大首次实现全光量子中继。



【中科大首次实现全光量子中继】



实验装置图

中国科学技术大学教授潘建伟及其同事陈宇翱、徐飞虎等在国际上首次实验实现全光量子中继器的原理性验证，为构建远距离光纤量子网络开辟了新途径。该成果于近日在国际学术期刊《自然-光子学》上在线发表。



人事变迁

重点：①紫光集团组建DRAM事业群，刁石京出任董事长。



【紫光集团组建DRAM事业群，刁石京出任董事长】

近日，紫光集团宣布组建DRAM事业群，任命刁石京为紫光集团DRAM事业群董事长，任命高启全为紫光集团DRAM事业群CEO。此次紫光组建DRAM事业群，标志着DRAM存储战略正式起步，将进一步拓宽紫光集团在存储器领域的相关布局，深化和完善紫光集团“从芯到云”产业链的建设。

【安靠中国区总经理周晓阳加盟初创公司广州芯聚能半导体】

近日芯谋研究顾文军在微博上爆料指出，全球第二大封装公司安靠中国区总经理周晓阳离职，将加入创业公司芯聚能半导体担任总裁。



焦点关注

重点：①科创板集成电路设计企业盘点：6家已受理、4家筹备中。
②日本对韩国禁运3种半导体关键材料，韩国电子业或将重创。



【科创板集成电路设计企业盘点：6家已受理、4家筹备中】

【科创板】集成电路设计企业盘点		
申请状态	企业名称	主要产品领域
注册生效	澜起科技股份有限公司	内存接口芯片及混合安全内存模组
	烟台睿创微纳技术股份有限公司	MEMS传感器及红外成像产品
	乐鑫信息科技（上海）股份有限公司	Wi-Fi MCU通信芯片及其模组
提交注册	晶晨半导体（上海）股份有限公司	多媒体智能终端SoC芯片
已问询	上海晶丰明源半导体股份有限公司	电源管理驱动类芯片
	聚辰半导体股份有限公司	EEPROM、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片
筹备中	北京紫光展锐科技有限公司	移动通信和物联网领域芯片
	上海复旦微电子集团股份有限公司	安全与识别芯片、非挥发存储器等
	芯原微电子（上海）股份有限公司	SoC芯片、SiP一站式解决方案
	苏州国芯科技股份有限公司	嵌入式CPU芯片与IP

截至7月8日，上海科创板已受理了142家企业提交的IPO申请，其中包括十多家集成电路相关企业，涵盖了设计、制造、设备、材料等产业链环节，在所有已受理的集成电路企业中，以设计企业的数量最多。



【日本限制对韩出口部分半导体及OLED材料】

据日本《产经新闻》6月30日报道，日本政府将从7月4日开始限制对韩国出口部分半导体、OLED材料出口。业内人士认为，日本限制关键材料出口韩国，波及韩国两大核心产业——面板和半导体，将影响SDC、LGD、SK海力士、三星半导体等韩国企业的相关业务，对韩国经济产生重大的影响。

【韩国加大半导体材料研发，应对日本对韩出口管制】

据韩联社报道，韩国产业通商资源部近日决定对半导体材料、零部件、设备研发投入6万亿韩元（约合人民币352.9亿元）的预算，以应对日本限制对韩出口。



专利要闻

重点：①自动驾驶、智能手机、先进显示技术等领域火热，各大公司纷纷申请新专利。



类别	公司/单位	事件内容
新专利	苹果	新专利：自动驾驶汽车将能实现自动无线充电。
新专利	苹果	新专利：可控制特定3D UI的投影系统。
新专利	三星	柔性屏新专利：手机两侧一拉 秒变平板。
新专利	三星	Galaxy Watch未来机型可能具有体脂测量表带。
新专利	IBM	柔性显示器设备专利：可变三种尺寸。
新专利	华为	曝光新语音处理方法。
新专利	微软	新双屏专利曝光：可根据光线变化调整亮度。
新专利	AMD	申请3D堆叠散热专利：妙用热电效应。



SIIP CHINA

【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投资平台。



联系我们

SEMI中国 Lily Feng
Tel: +86-21-60278500
E-MAIL: lifeng@semi.org
<http://www.semi.org.cn/siip>

订阅半导体产业新闻半月刊（精华版）欢迎来信索取
（来信请附名片并注明公司名称、职务、联系电话）
SEMI中国 Lily Feng
E-MAIL: lifeng@semi.org

